

科技部 函

地址：台北市和平東路二段 106
號

聯絡人：張庭軒 助理研究員

電話：02-2737-7437

傳真：--

電子信箱：tschang@most.gov.tw

受文者：國立嘉義大學

發文日期：中華民國 106 年 12 月 12 日

發文字號：科部工字第 1061011848 號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：如文附件 1 附件 2 附件 3 附件 4 附件 5 附件 6

主旨：本部推動「矽光子及積體電路」專案研究計畫，自即日起接受申請，請於 107 年 3 月 14 日(星期三)前函送本部，逾期不予受理，請查照轉知。

說明：

- 一、本專案計畫期以落實產學研密切結合之目標，故計畫團隊須邀請業界及法人單位參與規劃及執行，並於申請計畫時提供附件 1(業界合作意願書及合作內容說明)及附件 2(法人單位合作內容說明);另計畫書中須規劃研究項目及應用項目，且須針對各項核心技術，說明目前及計畫預定達成之技術成熟度(如附件 3)及成果指標說明(如附件 4);並請將附件 1-4 置於計畫書表 CM03 研究計畫內容最後。
- 二、本專案計畫須規劃前二年完成核心技術開發與系統晶片架構設計，第三年完成系統晶片製作與性能優化，第四年完成系統展示並能將技術與廠商進行後續之應用與推廣。
- 三、本專案計畫申請以單一整合型計畫為限，計畫書總計畫及所有子計畫全部書寫於一份計畫書，每一整合型計畫需含總計畫與至少 3 項子計畫，總計畫主持

人須同時主持 1 項子計畫，僅總計畫主持人列入本部
專題研究計畫件數計算。

- 四、本專案計畫之執行期程自 107 年 8 月 1 日開始。
- 五、本公告計畫經費係屬專款專用，恕不受理申覆。
- 六、本專案計畫相關申請規範與研究範疇等細節說明，
請詳閱本部網站()-動態資訊(計畫徵求)或工程司網站
()-公告事項。

七、本案聯絡人:

(一)相關計畫內容疑問，請洽本部工程司張庭軒先生，
電話: (02)2737-7437。

(二)有關係統操作問題，請洽本部資訊系統服務專線，
電話:0800-212-058，(02)2737-7590、7591、7592。

正本：專題研究計畫受補助單位（共 304 單位）

副本：本部綜合規劃司、工程司